

デバイス実装研究会の開催（2/17）の御案内

主催：アジア半導体機構 共催：三次元半導体研究センター、公益財団法人九州経済調査協会

新型コロナウイルス感染症のため、会場とオンラインのハイブリッド方式で開催致します。

今回は、7名の方をお招きし、先端パッケージ技術に関する研究開発ならびにビジネス動向についてお話しいただきます。是非、皆さまの事業・研究にお役立て頂きたい、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

会期：2023年**2月17日（金）14:00～18:00**（開場13:30）

会場：電気ビル共創館 3階 カンファレンス A（大会議室）+オンライン：Zoom ウェビナー
（〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号）

アクセス：地下鉄七隈線 渡辺通駅直結、西鉄バス 渡辺通1丁目電気ビル共創館前停より徒歩1分
御申込方法：事務局（九経調 HP）イベント掲載ページ（下記 URL）よりお申し込みください。

<https://www.kerc.or.jp/seminar/2023/01/217-1.html>

定員：会場：50名（150名収容の大会議室を定員1/3で使用します）

オンライン：100名

※懇親会は20名（先着順：開催時点の感染防止ガイドラインに則って実施可否を検討します）

会費：講演会 3,000円 懇親会 4,000円

備考：講演会参加費は、お申込みの際にクレジット決済でお願いします。懇親会費は、当日、受付にてお支払いください。なお、キャンセルの際に、ご返金できませんのであらかじめご了承ください。

■プログラム■

<講演会>

開会挨拶 14:00～14:05 アジア半導体機構 会長 森下 順（株式会社ウォルツ 代表取締役社長）

基調講演 14:05～14:45 「先端半導体微細接続と高信頼化に向けた取り組み」
大阪大学 産業科学研究所 特任教授（名誉教授）菅沼 克昭 氏

報告1 14:45～15:15 「ハイブリッド接合の低温化に向けた新規接着材料の開発」
三井化学株式会社 ICTソリューション研究センター
新事業G 研究員 岡太 航 氏

報告2 15:15～15:45 「企業連携による半導体パッケージ評価プラットフォーム」
株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部開発センター
パッケージングソリューションセンター
外部協創グループ JOINT2 チームリーダー 加藤 禎明 氏

ブレイク

報告3 15:55～16:25 「次世代半導体パッケージ技術を支えるためのCSIPOSの研究・開発」
福岡大学 半導体実装研究所 研究エンジニア 客員教授 韓 榮建 氏

報告4 16:25～16:55 「アドバンスドパッケージにおけるアンダーフィル技術動向」
ナミックス株式会社 ナミックスフェロー 鈴木 理 氏

報告5 16:55～17:25 「高密度パッケージ基板の開発動向」
新光電気工業株式会社 開発統括部プロセス開発部 主任研究員 三木 翔太 氏

報告6 17:25～17:55 「深紫外（波長266nm）ピコ秒パルスレーザの紹介と加工事例」
スペクトロニクス(株) 取締役創業者 岡田 穰治 氏

閉会挨拶 17:55～18:00 アジア半導体機構 副会長 高木 タッド（台井科技股份有限公司 総経理）

<懇親会>

※講演会が終わり次第、講演会会場近くにて開催いたします。

お問い合わせ先：

アジア半導体機構事務局：公益財団法人九州経済調査協会 担当：横寺、相川、岡野

Tel：092-721-4900 E-mail：astsa@kerc.or.jp

住所：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館5F

本年度のデバイス実装研究会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、会場とオンラインのハイブリッド方式にて開催いたします。

尚、会場での聴講をお申し込みいただいた方も、新型コロナウイルス感染状況により、オンラインのみでの開催になる場合がございます。皆様には、大変ご不便をおかけするかとは存じますが、お申込の際は、必ず e-mail アドレスをご記入いただきますようお願い致します。



■お申込方法：九経調ホームページ (<https://www.kerc.or.jp>)

または QR コード よりお申し込みください。

お申込 URL：<https://www.kerc.or.jp/seminar/2023/01/217-1.html>

■定 員： 会場 50 名

オンライン 100 名 ※事前登録が必要です

■参加費： 講演会 3,000 円 懇親会 4,000 円

※講演会参加費は、お申込みの際にクレジット決済でお願いします。

※懇親会費は、当日、受付にてお支払いください。

※キャンセルの際に、ご返金できませんのであらかじめご了承願います。

■お申し込み後のご連絡：

ホームページからお申込み後、参加費お支払いのご案内メールが届きます。会場参加・オンライン参加を問わず、全員に Zoom URL がついたメールが届きます。会場参加予定の方も必要に応じて Zoom をご活用いただければ幸いです。

※登録いただいたメールアドレス宛に、開催時間 1 時間前になりましたらリマインドメールをご送付いたします。ZoomURL ならびに当日資料を送付いたします。

■その他：

※1：ネット配信サービス「ZOOM」にてライブ配信致します。事前のアプリインストール（無料）を推奨しますが、それが難しい方は、WEB ブラウザ（Google Chrome）からご参加ください。

※2：安定した Wi-Fi 環境下でご視聴ください。

※3：参加者の映像・音声・お名前などは表示されません。

以上

■協賛金ご協力をお願い■

デバイス実装研究会は、皆さまからの「参加費」で運営しています。内容の充実と今後の持続的な活動のために、皆さまからの協賛金（一口 10 万円）を募らせていただきます。ご賛同いただける方は、担当まで mail にてご一報いただき、以下の口座にお振り込みください。皆さまのご協力、心からお願い申し上げます。

福岡銀行 本店営業部 普通 5617135

口座名義：ASTSA アジア半導体機構 事務局長 岡野 秀之

アストサ アジアハンドウタイキコウ ジムキョクチョウ オカノヒデユキ

mail: okano@kerc.or.jp

※協賛金依頼状ならびに受領書を発行させていただきます。